BGA パッケージ フラッシュ デバイスの BGA 基板サイズ – KBA236219

フラッシュ デバイスの基板サイズ (フラッシュ デバイスのソルダー マスク開口部とも呼ばれます) は、SMD フラッシュ メモリ パッケージの場合、顧客が常に利用できるとは限りません。 フラッシュ データシートの Physical Diagrams では、この値は最小のはんだボール サイズとして参照できます。

たとえば、S25FS064S FAB024 BGA 24 ボール 6x8 mm パッケージの公称ボール サイズとボール ピッチは、それぞれ 0.4 mm と 1.00 mm です。 この場合、フラッシュ デバイスの基板サイズは、0.35 mm の最小はんだボール サイズまで小さくすることができます。

